

全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2022]26 号

关于召开 2022 年度全国半导体设备和材料标准化技术委员会 材料分技术委员会年会的通知

各位委员、各会员单位及相关单位：

为全面贯彻《国家标准化发展纲要》，落实相关行动计划和规划，根据国家市场监督管理总局、工业和信息化部以及中国有色金属工业协会下达的有关标准制修订计划的文件精神和标委会工作需要，现定于 2022 年 11 月 21 日～11 月 24 日在江苏省徐州市召开 2022 年度全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会年会，请全体委员务必出席会议，同时请各会员单位、各起草单位及相关单位派代表参会。现将会议有关事宜通知如下：

一、会议日程和会议内容

- 1、11 月 21 日，全天报到。
- 2、11 月 22 日，上午 8:30～12:00 举行全体大会，会议内容如下：
 - ① 领导讲话。
 - ② 全国半导体材料标准化分技术委员会秘书处作 2022 年度工作报告。
 - ③ 颁发第五届半导体材料标委会委员证书，表彰 2022 年度全国半导体材料分标委会“技术标准优秀奖”、“特殊贡献奖”和“先进工作者”。
 - ④ 行业技术交流及研讨。
- 3、11 月 22 日，下午 14:00～18:00 继续全体大会，会议内容如下：
 - ① 终审 2022 年度审定完成的标准项目，审议半导体材料标准体系。
 - ② 论证 2023 年度半导体材料标准计划项目。请所有项目提出单位按照《关于征集 2022 年度全国半导体材料标准化分技术委员会年会论证的标准计

划项目的通知》（半材标委[2022]20号）的要求，提前准备相关论证材料。秘书处将于年会前汇总所有需要论证的新计划项目，会议期间原则上不再接收新项目建议。

4、11月23日，上午8:30开始分组会议，会议内容如下：

对《高纯镓》等13项半导体材料国家和行业标准进行讨论（具体项目见附件）。请各标准负责起草单位于11月16日前将相关标准稿件发送至秘书处邮箱(tc203sc2@cnsmq.com)，由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于11月18日之后在有色标准信息网（www.cnsmq.com）“标准制定工作站”栏目下载会议资料。

5、11月24日早餐后返程。

二、报到时间、地点及乘车路线

1、报到时间：2022年11月21日。

2、报到地点：徐州开元名都大酒店（徐州市泉山区湖西路1号，0516-87888888）。

3、乘车路线：①徐州东站：乘坐地铁1号线至工农路站下车，至湖滨新村站换乘公交68路或59路，至开元名都站下车，步行约100米到达酒店。乘出租车约17公里，约50元。②徐州站：乘坐地铁1号线至工农路站下车，至湖滨新村站换乘公交68路或59路，至开元名都站下车，步行约100米到达酒店。乘出租车约7公里，约25元。③徐州观音国际机场：乘坐机场大巴1号线至徐州汽车总站，换乘地铁1号线至工农路站下车，至湖滨新村站换乘公交68路或59路，至开元名都站下车，步行约100米到达酒店。乘出租车约45公里，约130元。

三、会务及联系人

本次会议由徐州市经济技术开发区管理委员会、徐州经开区科技镇长团和中国电子科技集团公司第四十六研究所共同协办。

会议期间，食宿统一安排，宿费自理。

标委会秘书处：李素青 010-62565659 15652368697。

会议会务组：18709316115（会议会务）、010-62257692（缴费、发票）。

四、会议报名及缴费

请参会代表务必于 2022 年 11 月 16 日前登录会议报名系统 (<http://www.ysmeeting.net>) 注册、完善个人信息、住房需求及单位发票信息。本次会议收取会议费 850 元/人。为保障会议用房安排和会议资料的准备, 11 月 16 日之后及现场缴费收取 1200 元/人。汇款请注明: 11 月半材年会(个人汇款请备注单位名称)。汇款账户信息如下:

收款单位: 有色金属技术经济研究院有限责任公司

开户行: 中国光大银行北京中关村支行

账号: 0875 0812 0100 3010 18526

附件: 讨论的标准项目

重要提示:

- (1) 请参加会议的人员报名前向所在单位报备, 了解出发地及会议地具体防疫要求, 经主管领导或防疫主管部门审批通过后方可外出;
- (2) 疫情防控不容松懈, 请参会代表于参会途中、参会期间、返程途中务必按照相关疫情防控要求做好个人防护, 并配合相关部门的防疫工作;
- (3) 报到时, 请参会代表出示健康防疫码;
- (4) 因处于疫情高风险地区和中风险地区而无法出席会议的代表, 可提前将对标准的反馈意见以书面形式提交至秘书处。

抄报: 全国半导体设备和材料标准化技术委员会



附件：

讨论的标准项目

序号	计划文号及编号	项目名称	主编单位	备注
第一组				
1	国标委发[2021]41 号 20214648-T-469	高纯镓	有研国晶辉新材料有限公司	讨论
2	国标委发[2021]23 号 20213238-T-469	碳化硅晶体材料缺陷图谱	东莞市天域半导体科技有限公司	讨论
3	国标委发[2021]23 号 20213239-T-469	蓝宝石图形化衬底片	广东中图半导体科技股份有限公司	讨论
4	国标委发[2021]28 号 20214216-T-469	III 族氮化物半导体材料中位错成像的测试 透射电子显微镜法	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	讨论
5	国标委发[2021]41 号 20214653-T-469	半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测识别判据 第 1 部分：缺陷分类	中国电子科技集团公司第十三研究所	讨论
6	国标委发[2021]41 号 20214649-T-469	半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测识别判据 第 2 部分：缺陷的光学检测方法	中国电子科技集团公司第十三研究所	讨论
7	国标委发[2021]41 号 20214654-T-469	半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测识别判据 第 3 部分：缺陷的光致发光检测方法	中国电子科技集团公司第十三研究所	讨论
第二组				
8	国标委发[2021]41 号 20214650-T-469	硅中代位碳含量的红外吸收测试方法	中国电子科技集团公司第四十六研究所	讨论
9	国标委发[2021]41 号 20214647-T-469	半导体晶片近边缘几何形态评价 第 1 部分：高度径向二阶导数法（ZDD）	山东有研半导体材料有限公司	讨论
10	国标委发[2022]17 号 20220133-T-469	埋层硅外延片	南京国盛电子有限公司	讨论
11	工信厅科函[2021]291 号 2021-1758T-YS	二氧化碳排放核算与报告要求 多晶硅企业	中国恩菲工程技术有限公司	讨论
12	工信厅科函[2021]291 号 2021-1759T-YS	多晶硅企业能源管理中心技术规范	新特能源股份有限公司	讨论
13	工信厅科函[2021]291 号 2021-1760T-YS	多晶硅行业能源管理体系实施指南	新特能源股份有限公司	讨论